

## Produktbeschreibung

---

GENMA Elektroniklot NP303T (SAC300) – kupferfreie Legierung zum Nachfüllen bei erhöhtem Kupfergehalt im Lötbad. Ein spezieller Produktionsprozess minimiert die Bildung von Oxyden und beugt der Lötbrückenbildung vor.

## Technische Eigenschaften

---

	Spezifischer Wert	Testmethode
<b>Legierung (wt %)</b>	Sn 97 / Ag 3,0	
<b>Schmelzbereich (°C)</b>	221 - 223	IEC61189-11
<b>Barrengröße in mm (Länge x Breite x Höhe)</b>	396 ± 5 x 20 ± 2 x 7,5 ± 3 (Other shapes available on request)	
<b>Barren Gewicht in kg</b>	0,45 ± 0,05	
<b>Lagerung</b>	trocken	

## Konformität

---

Konform mit RoHS-Richtlinie 2011/65/EU